



Bergquist (Henkel)

предлагает различные решения для контроля нагрева и обеспечения оптимальной

производительности, продлевая срок службы устройств.

Материалы Bergquist (Henkel) используются для контроля температуры, в том числе уплотнители зазоров **GAP PAD**[®], продукты для термоконтроля **SIL PAD**[®], материалы с фазовым переходом, **microTIM**, **LIQUI FORM** и термоклеи, решают самые сложные современные задачи по термоконтролю.

GAP PAD[®] обеспечивают эффективную теплопроводность между радиаторами и электронными устройствами, где присутствует неровный рельеф поверхности, воздушные зазоры и шероховатая текстура поверхности.

Семейство материалов **BOND-PLY** является теплопроводным и электроизолирующим. BOND-PLY доступен как с адгезивом (PSA) так и без адгезива. Адгезивный BOND-PLY обеспечивает разделение склеенных материалов с несовпадающими коэффициентами термического расширения. При использовании BOND-PLY возможна замена адгезива, клея термоотверждения, винтового крепления, креплений с зажимами.

Материалы **SIL PAD**[®] предназначены для тех применений, где необходима максимальная теплопередача и не требуется электрическая изоляция, что делает SIL PAD[®] идеальным материалом для теплопроводности, устройств загрязненных термосмазкой. При использовании этого материала устраняются проблемы, связанные со смазкой, такие как загрязнение припоя и постоянная операции очистки. Вместо смазки можно использовать SIL PAD[®] TSP Q2500. SIL PAD[®] TSP Q2500 также исключает возможность осаждения пыли, которая может привести к возможному возникновению замыкания на поверхности или перегреву.



Теплоизоляционные и теплопроводные материалы Bergquist

Наименование	Описание	цвет	Толщина (дюйм)	Твердость объемного образца резины (Shore 00)	Электрический пробой (переменный ток)	Объемное сопротивление (Ом-м)	Теплопроводность (В/м-К)	Тепловое полное сопротивление (% деформация) (°С-дюйм ² /В)			Горючесть (UL 94)
								10%	20%	30%	
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 1000VOUS (Пржнее наименование GAP PAD® VOUS)	силиконовая основа армированная стекловолокном	лиловый/розовый	0,020 - 0,250	5	6,000	1 x 10 ¹¹	1,0	10% 1,97	20% 1,87	30% 1,68	V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 1100SF (Пржнее наименование GAP PAD® 1000SF)	полимерная основа армированная стекловолокном, без силикона	зеленый	0,010 - 0,125	40	> 6,000	1 x 10 ¹⁰	0,9	-			V-1
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 1350 (Пржнее наименование GAP PAD® 1450)	силиконовая прокладка с прочным основанием	светло-розовый	0,020 - 0,125	30	> 6,000	1 x 10 ⁹	1,3	-			V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 1500 (Пржнее наименование GAP PAD® 1500)	неармированная силиконовая прокладка	черный	0,020 - 0,200	40	> 6,000	1 x 10 ¹¹	1,5	10% 1,62	20% 1,50	30% 1,33	V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 1500R (Пржнее наименование GAP PAD® 1500R)	силиконовая основа армированная стекловолокном	черный	0,010 - 0,020	45	> 6,000	1 x 10 ¹¹	1,5	10% 1,07	20% 0,88	30% 0,82	V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 2200SF (Пржнее наименование GAP PAD® 2200SF)	полимерная основа армированная стекловолокном, без силикона	зеленый	0,010 - 0,125	70	> 5,000	1 x 10 ⁸	2,0	-			V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 3004SF (Пржнее наименование GAP PAD® 3004SF)	полимерная основа без силикона с прочным основание	светло-серый	0,010 - 0,125	70	> 5,000	1 x 10 ¹¹	3,0	-			V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 3500ULM (Пржнее наименование GAP PAD® 3500ULM)	силиконовая основа армированная стекловолокном со сверхнизким модулем упругости	серый	0,020 - 0,125	-	> 5,000	1 x 10 ¹⁰	3,5	10% 0,50	20% 0,44	30% 0,39	V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP HC3000 (Пржнее наименование GAP PAD® HC3.0)	силиконовая основа армированная стекловолокном	голубой	0,020 - 0,125	15	> 5,000	1 x 10 ¹⁰	3,0	10% 0,57	20% 0,49	30% 0,44	V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP HC5000 (Пржнее наименование GAP PAD® HC5.0)	силиконовая основа армированная стекловолокном	фиолетовый	0,020 - 0,125	35	> 5,000	1 x 10 ¹⁰	5,0	10% 0,35	20% 0,30	30% 0,26	V-0

